統新光訊股份有限公司

APOGEE OPTOCOM CO., LTD.

上市股票代號：6426



免責聲明

1. 本簡報中所提及之資訊包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容，乃是建立在本公司從內部與外部來源所取得的資訊基礎。

2. 本簡報資料所提供之資訊含有前瞻性敘述，這些前瞻性敘述將受風險、不確定性及其他因素所影響，實際結果可能與前瞻性敘述不相同。

3. 本公司不保證本簡報資料之正確性，且所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性或完整性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。

4. 本公司不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。

公司簡介

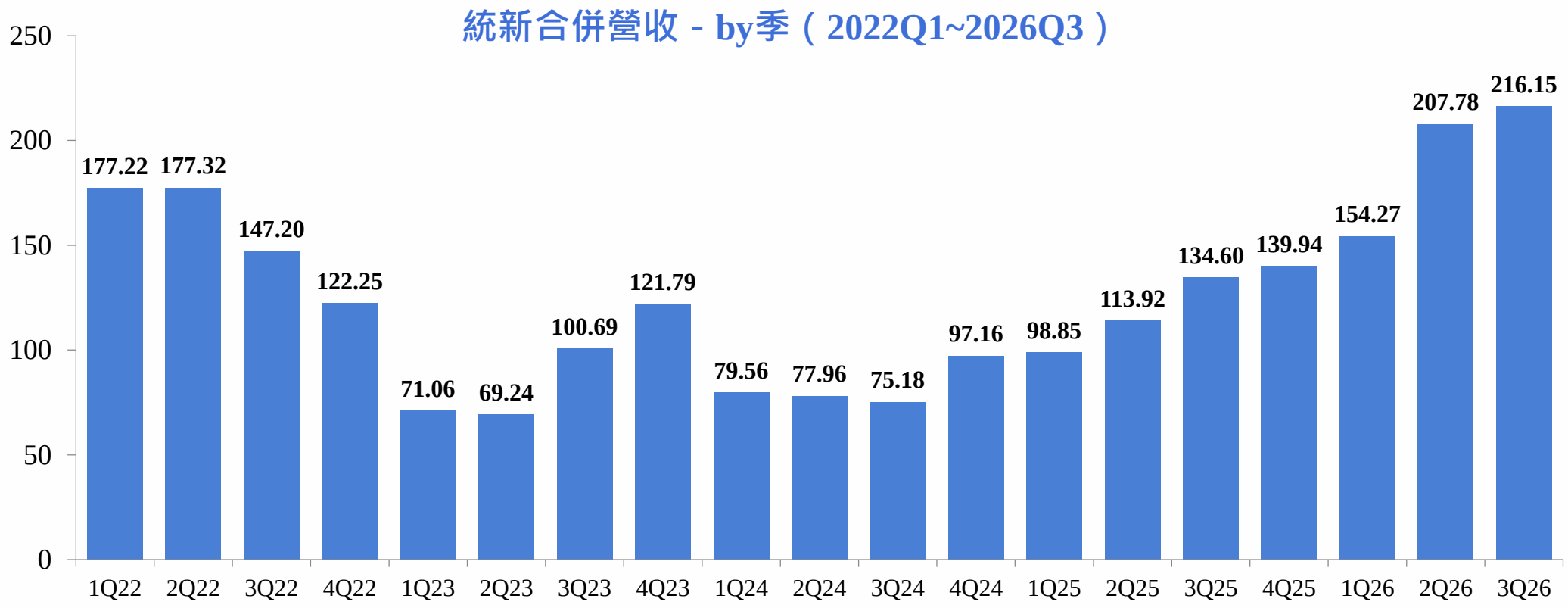
公司名稱 / 地址	**統新光訊股份有限公司 (APOGEE OPTOCOM CO., LTD.)** 744 台灣台南市新市區南科三路7號4樓
公司沿革	上市日期：2021年 03月 24日
	上櫃日期：2014年 12月 17日
	興櫃日期：2013年 10月 18日
	設立日期：2003年 08月 01日
董事長	李 英坤
總經理	魏 敬易
實收資本額	3.85億 [截至 2026年 09月 30日]
公司員工數	222名 [截至 2026年 09月 30日]
主要營業項目	光通訊 主動 / 被動元件 使用之薄膜濾光片 光學鍍膜元件 & ODM
主要股東	鼎峰投資 (16.48%) 、 勝霖投資 (14.25%)



南科廠 6,930平方公尺

合併營收季度趨勢（2022Q1–2026Q3）

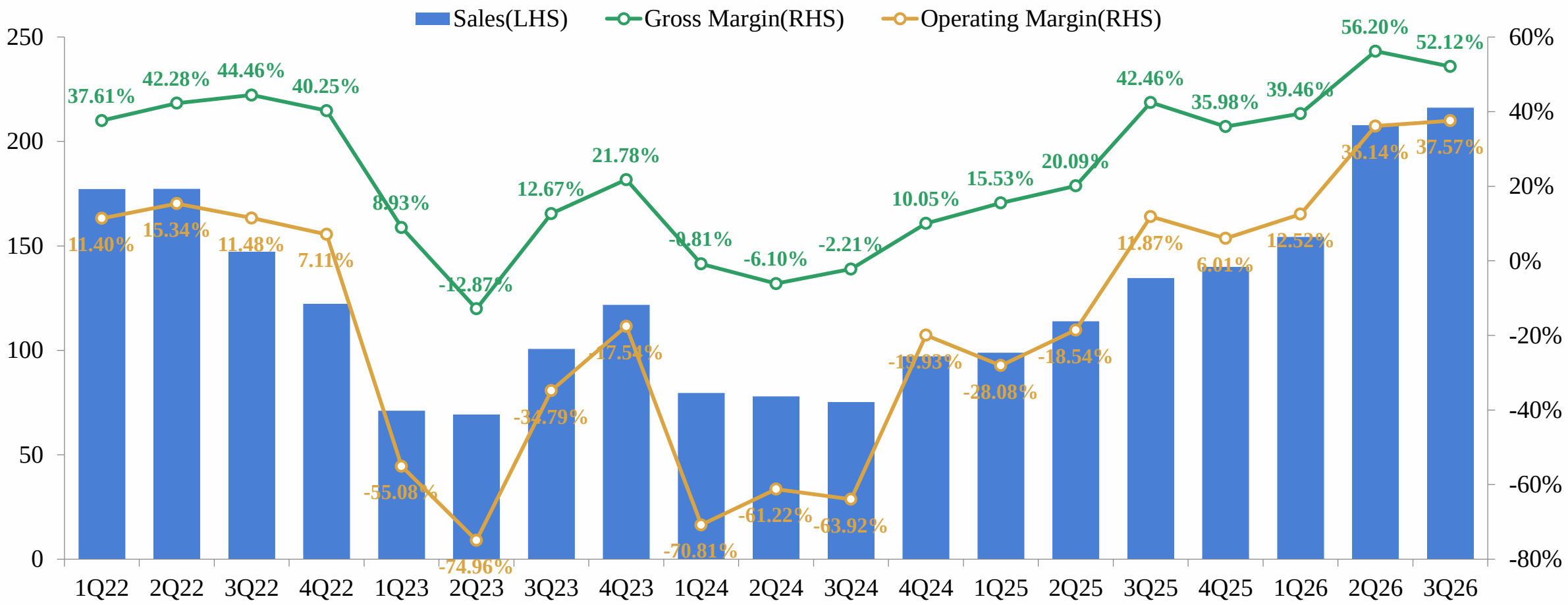
- **營收連續8季成長：3Q26營收NT$216.15M創新高（年增61%），公司持續聚焦AI資料中心互連(DCI)等光通訊應用。**



單位：新台幣百萬元（NT$M）

2026年第三季合併財務績效

3Q26 總營收	3Q26 毛利率	3Q26 營業利益率	3Q26 淨利	3Q26 EPS
NT$216.15M	52.12%	37.57%	NT$79.36M	NT$2.06



合併稅後淨利（2014–2025年度及2026前三季）

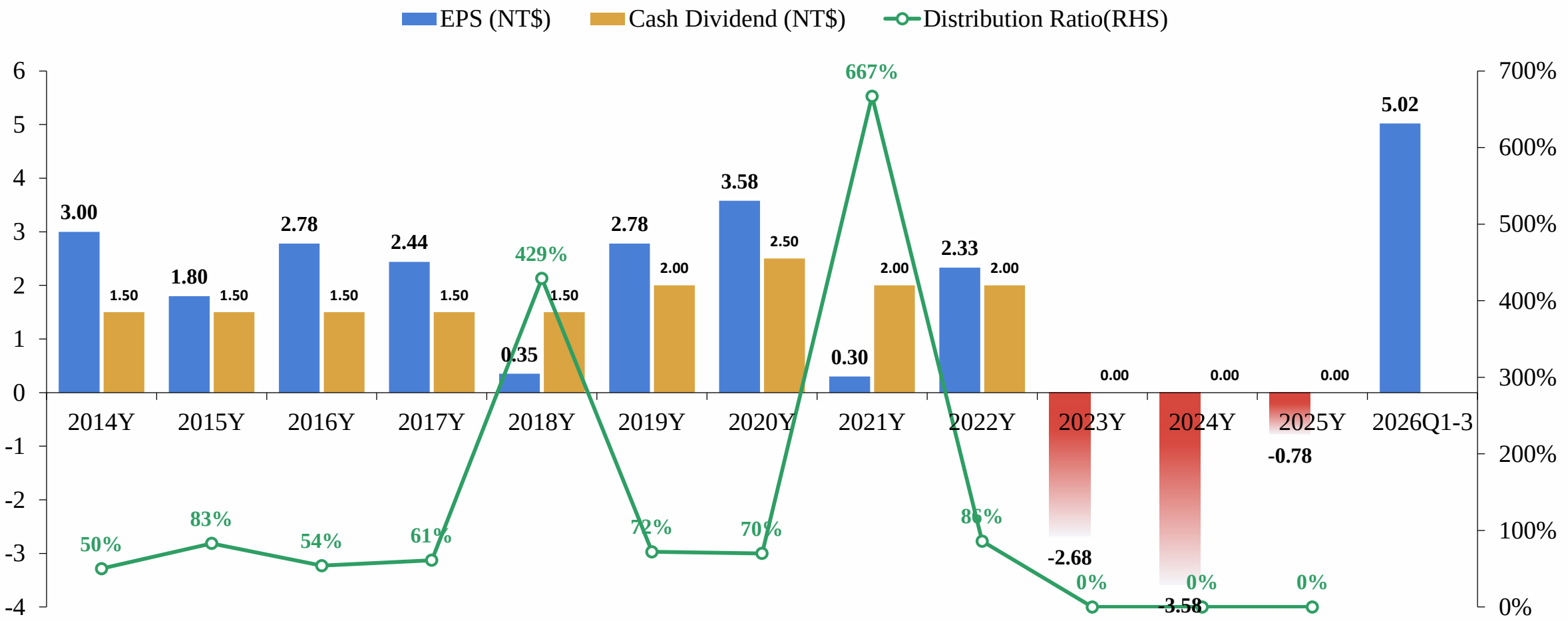
2025Y 全年淨利	2026Q1-3 淨利	單位：新台幣百萬元（NT$M）
NT$-29.99M	NT$193.40M	



每股盈餘與股利配發（2014–2025年度及2026前三季）

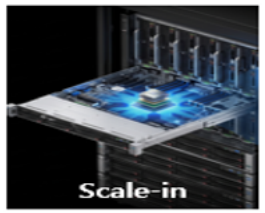
2026Q1-3 EPS
NT$5.02

單位：新台幣元；%



■ 2023、2024及2025年度另有資本公積發放現金（每股配發新台幣0.5元）

AI基建五大核心



Scale-in：

晶片對晶片 (Chip-to-Chip)與板載光學。



Scale-up：

伺服器機櫃內部 (NVLink鏈路)，利用光連結取代傳統銅線。

FAU coating



Scale-out：

同一座資料中心內，伺服器與交換機樹狀網路(Cluster)間的1.6T模組串聯。

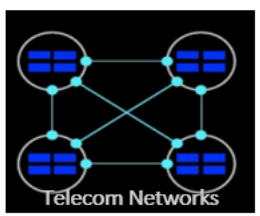
TOSA & ROSA's filters for 1.6T



Scale-across：

當單一資料中心面臨電力供應、空間與散熱瓶頸時，運算叢集必須分散至數公里外甚至不同園區的multiple data centers，並透過超高頻寬、低延遲的光鏈路連成一體。

WDM filters

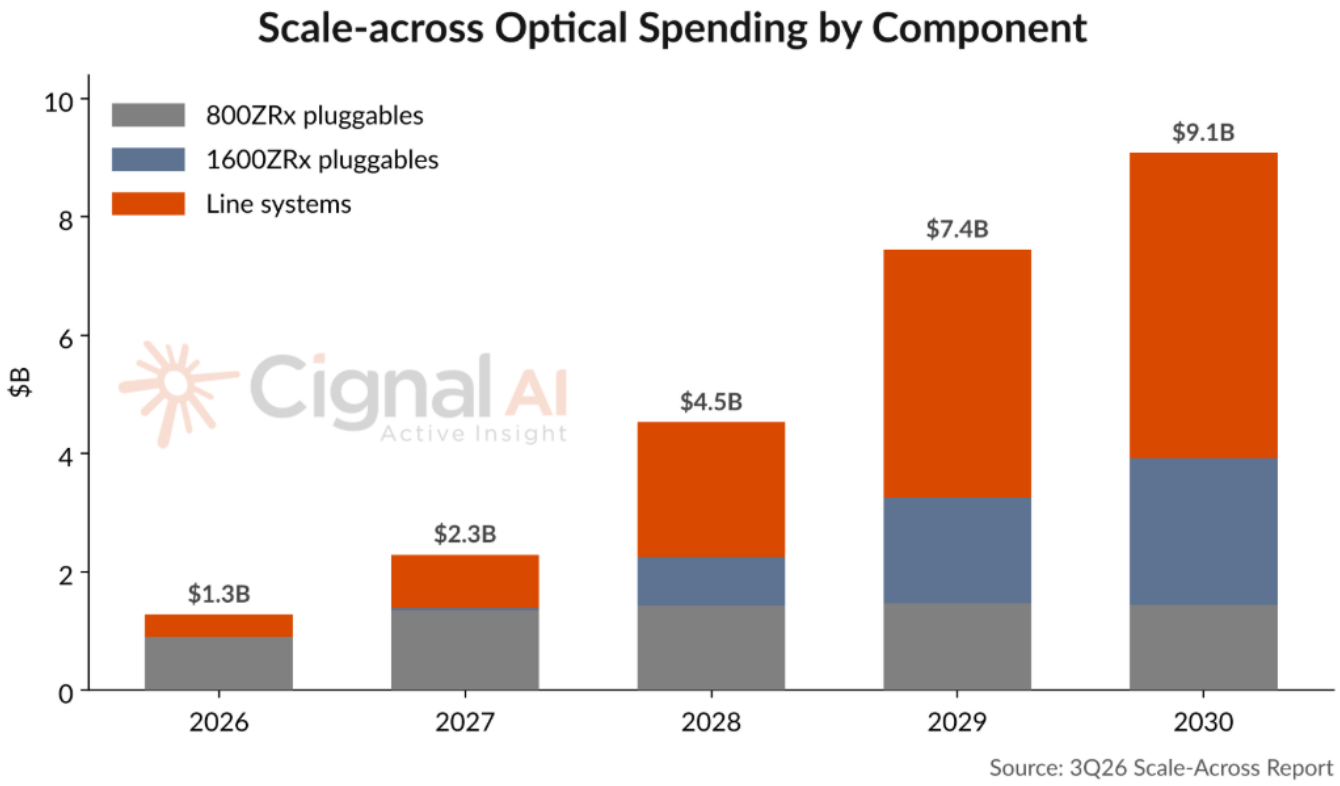


Telecom Networks：

電信骨幹與跨域長距光互連，支援分散式 AI 節點互通。

WDM filters

2026–2030 年全球 Scale-Across 光學支出趨勢與關鍵解析



•Scale-across 的光學營收將在 2030 年達到 91 億美元，2026 年至 2030 年的累計營收將達到 246 億美元。Scale-across 將於 2027 年超越前端資料中心互連（front-end DCI）。到了 2030 年，其出貨頻寬將是前端 DCI 的 3 倍以上，可插拔模組的支出則是其 2 倍。

•市場原先多聚焦於可插拔模組，但隨著多軌（Multi-rail）與拉曼放大技術的普及，包含終端、線上放大器與管理軟體的「線系統」（圖中橘色部分）將在 **2028 年超越可插拔模組**，至 2030 年將佔據整體市場的過半營收。

•頻寬規格正從 800ZRx（灰色）快速過渡至 **1600ZRx（藍色）**，預計到 2030 年，1600ZRx 將承載高達 70% 的 Scale-Across 頻寬。

•**主要受惠大廠**：報告指出積極投資多軌線系統的廠商，如 **Ciena、Cisco 和 Nokia** 最具備獲利條件（同時也呼應了 Coherent、Lumentum 等上游雷射與零組件霸主的巨大商機）

資料來源:市調機構Cignal Ai

ADVANCED THREE-TIER OPTICAL INFRASTRUCTURE

DCI Scale-Across 連結架構與三級濾片部署藍圖

宏觀波段分離（Band Level）➔ 中繼頻段細分（BWDM Sub-band Level）➔ 微觀單通道細析（DWDM Channel Level）

第一級：宏觀波段分離（Band Level - 主幹基礎鋪設）

[S-band BPF]
(未來容量預留區)

[C-band BPF]
(核心傳輸波段)

[L-band BPF*]
(容量擴充波段)

[U-band 8nm BPF]
(帶外 OTDR 專用監測)

第二級：中繼頻段細分（BWDM Sub-band Level - 獨立頻譜區段切片）

S-band BWDM 濾片群
BPF_BWDM 11nm 帶寬切片

C-band BWDM 濾片群
BPF_BWDM 1531.9~1560.9nm

L-band BWDM 濾片群
BPF_BWDM 1576.2~1606.6nm

第三級：微觀單通道細析（Channel Level - 高速服務按需疊加）

[C-band 密集 DWDM]
（大量採購主力）
➔ 送往 ZR 發射器

[L-band 密集 DWDM]
（隨雙波段擴充）
➔ 送往 ZR 發射器

INDUSTRY INSIGHTS & REFERENCES

AI 時代 DCI 流量轉型與傳輸本質差異

從「靜態儲存與高壓縮」轉向「1:1 無損、零延遲的算力串聯」

傳統資料中心 (儲存與雲端) 1:22.5

高壓縮比，以檔案儲存、備份與網頁瀏覽為主。

- **流量特點**：資料可透過重複刪除與壓縮大幅縮減。
- **延遲要求**：可容忍數十至數百毫秒的緩衝與延遲。

AI 資料中心 (分散式叢集) 1:1

無損即時傳輸，支援萬卡 GPU 分散式大模型訓練。

- **流量特點**：交換梯度與啟動值矩陣，完全無法壓縮。
- **延遲要求**：追求極致零丟包與零延遲，避免 GPU 閒置。

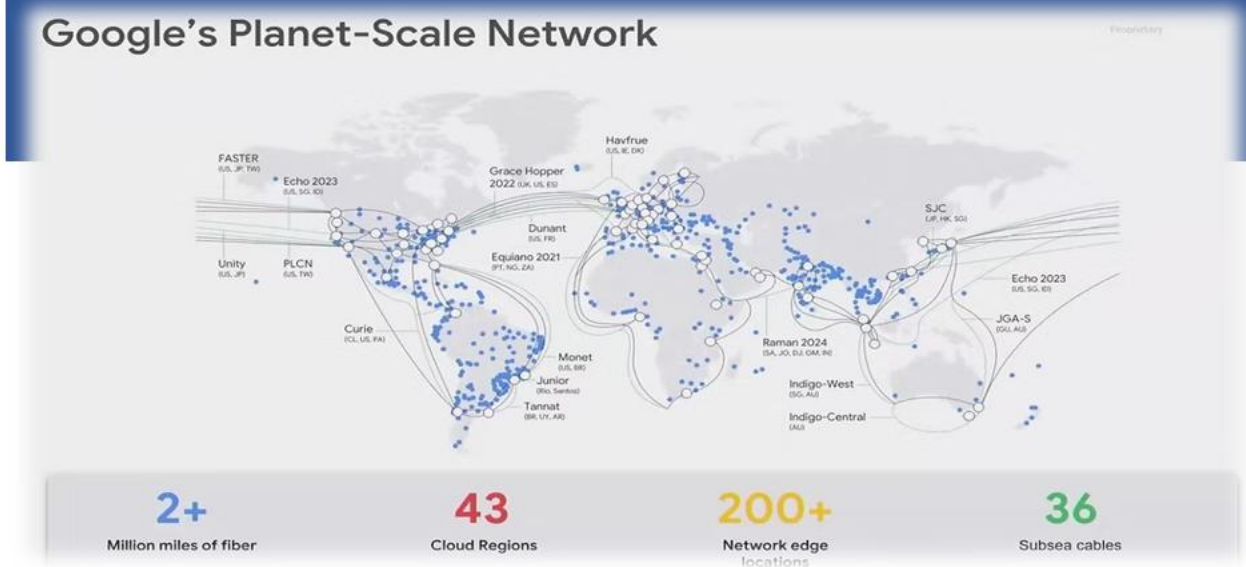
核心結論：算力連結需求引爆 Scale Across (DCI) 頻寬激增，推動 1:1 相干光學與 DWDM 濾片剛性需求。

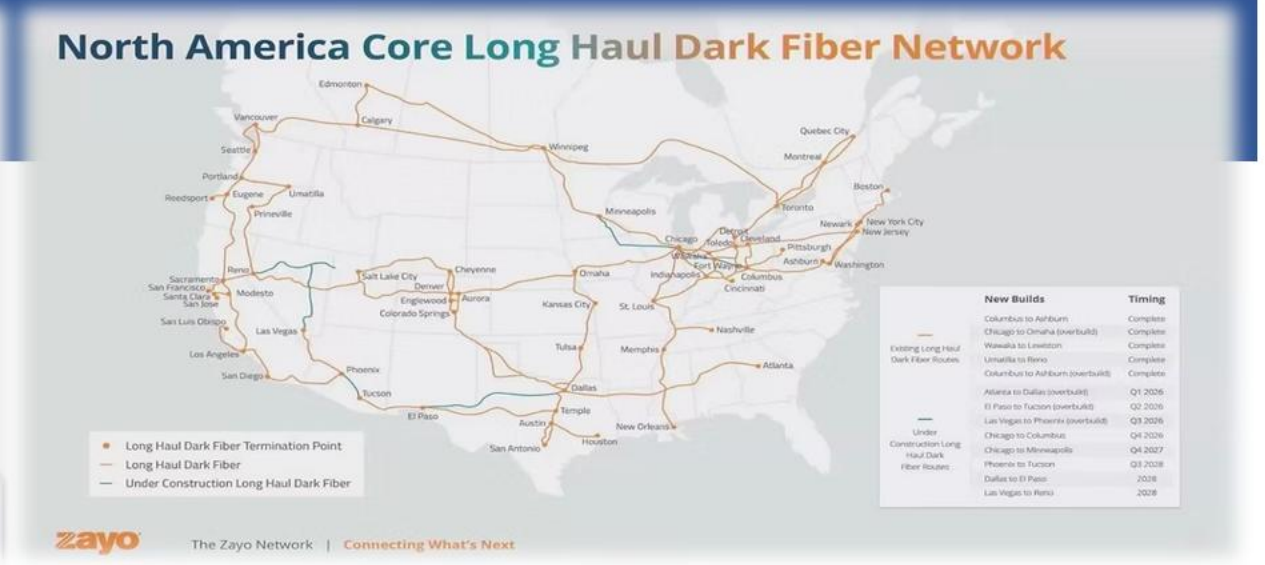
資料來源：產業架構分析與公開文獻

全球規模網路佈局：全球雲端運算節點與跨洲光纖

Google 的全球規模網路
200+ 萬英里光纖 (Million miles of fiber)
43 個雲端區域 (Cloud Regions) 與 200+ 個網路邊緣位
36 條海底光纜 (Subsea cables)
從「內部算力」轉向「跨洲/跨機房協同 (Scale-Across)」
過去幾年，AI 基礎設施的焦點多半集中在單一機房內部的 Scale-up (GPU 互連) Scale-out (節點互連)。
隨著 AI 模型訓練規模呈指數級成長，單一機房的電力與土地極限逼使雲端服務商 (CSP) 必須將算力分散至不同城市甚至是不同國家。
這張圖所呈現的海底光纜與陸地骨幹網路，正是實現 Scale-Across (DCI 資料中心互連) 的實體大動脈。

2026/3/2 NVIDIA宣佈各投資 20億美元給Lumentum 與 Coherent光通大廠
2026/5/6 NVIDIA宣佈與康寧合作，首階段斥資 5億美元 (投資規模最高可達 32 億美元)，雙方將在美國北卡羅來納州與德克薩斯州新建 3 座先進製造廠
2026/7 NVIDIA 砸百億買下暗光纖
Lumen Technologies目前擁有 1,700 萬英里光纖，並計畫在未來 3-5 年內透過與 Corning 的合作再增加 4,100 萬英里。





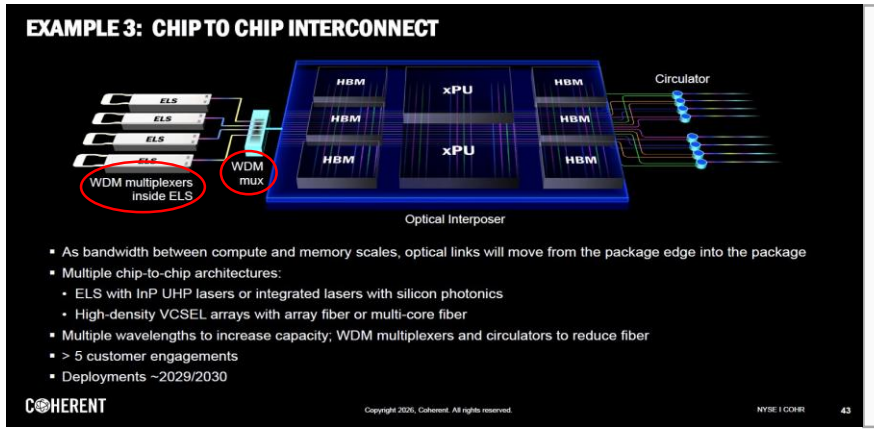
Coherent Product Launch at ECOC, 2026

03. Coherent 2026 ECOC 產品發表

•推出全新PhotonLink平台：

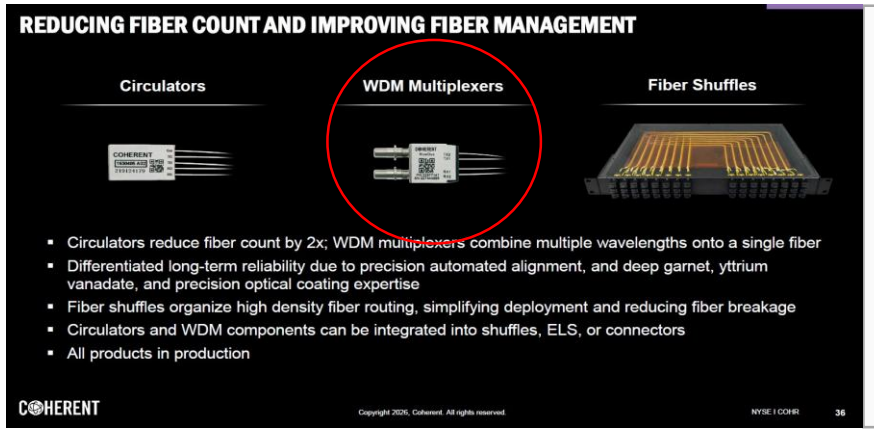
正式發表全新的整合光學平台PhotonLink™，旨在應對AI資料中心從傳統電氣連接轉向光通訊的架構轉型，涵蓋共封裝光學 (CPO)、近封裝光學 (NPO) 以及晶片間光學互連。

資料來源：Coherent Product Launch at ECOC, 20260921



晶片對晶片

- ELS內部含WDM多工器 + **WDM**多工器 + 光學中介層 + 環形器
- 隨著運算單元與記憶體之間的頻寬規模擴大，光學連接將從封裝邊緣移至封裝內部。
- 多種晶片對晶片架構。
- 採用多重波長以增加容量；利用**WDM**多工器與環形器來減少光纖數量。
- 預計於2029至2030年左右進入量產部署。
- 目前超過5個客戶專案接洽中。



減少光纖數量與提升光纖管理

- **WDM**多工器 + 環形器 + 光纖分路器/理線盤
- 環形器可將光纖數量減少2倍；**WDM**多工器能將多重波長合併至單一光纖中。
- 具備差異化的長期可靠性，歸功於精密的自動化對準技術，以及深厚的石榴石、釩釔酸鹽與精密光學鍍膜專業技術。
- 理線盤可組織高密度光纖路由，簡化部署並減少光纖斷裂。
- 環形器與**WDM**元件可整合至理線盤、ELS或連接器。
- 所有產品皆已進入量產階段。

關於跨域擴展（Scale-Across / 資料中心互連 DCI）--- FROM Coherent CEO Jim Anderson(11/5)公開訪談

跨域擴展（Scale-Across / DCI）是本季財報中最亮眼的成長引擎之一：

- 高速成長動能：第一季跨域擴展營收超過 2 億美元，較去年同期成長近四倍，年化營運轉率已逼近 10 億美元。
- 成長驅動力：受到分散式 AI 工作負載橫跨多個資料中心、推動超大規模資料中心業者對資料中心間高頻寬光學連接需求的強勁帶動。
- 未來展望：隨著全新 multi-rail 解決方案預計在 3 月季度開始出貨，管理層預期到 2027 日曆年底前，每季的跨域擴展營收將比第一季水準再成長約一倍。

因應跨園區傳輸需求，Coherent推出的新版可插拔光線路系統支援800G ZR及ZR+同調光通訊，可在一對光纖上承載最多32個波長，傳輸容量最高達25.6Tbps，適用距離為2至200公里。

Thank you for your attention .

Have a great day !

